

Title (en)

Method of making a surface element for absorbing electromagnetic waves.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines Absorbiererelements für elektromagnetische Wellen.

Title (fr)

Procédé de fabrication d'un élément de surface pour l'absorption des ondes électromagnétiques.

Publication

**EP 0414613 A2 19910227 (FR)**

Application

**EP 90402343 A 19900823**

Priority

DE 3928018 A 19890824

Abstract (en)

The invention proposes a method of making a surface element (1) which absorbs electromagnetic waves. Strips or plates of mineral wool (3) are stacked up, whilst inserting strips or plates (4) of an electrically conducting material. The stacks are cut up into vertical slices and glued, cutting surface side, to a support-strip (2). <??>The invention applies in particular to constructions in airport localities. <IMAGE>

Abstract (fr)

L'invention propose un procédé de fabrication d'un élément de surface (1) absorbant les ondes électromagnétiques. Des bandes ou plaques en laine minérale (3) sont empilées en intercalant des bandes ou plaques (4) en une matière électroconductrice Les piles sont débitées en tranches verticales et collées, côté face de coupe sur une bande-support (2). L'invention s'applique notamment aux constructions dans les zones aéroportuaires.

IPC 1-7

**B32B 7/02**; **H01Q 17/00**

IPC 8 full level

**B32B 7/02** (2006.01); **B32B 37/00** (2006.01); **D06M 17/00** (2006.01); **H01Q 17/00** (2006.01); **H05K 9/00** (2006.01); **E04B 1/76** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01Q 17/005** (2013.01 - EP US); **E04B 2001/7683** (2013.01 - EP US); **Y10S 428/92** (2013.01 - EP US); **Y10T 156/1059** (2015.01 - EP US); **Y10T 156/1075** (2015.01 - EP US)

Cited by

EP1679945A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DK ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0414613 A2 19910227**; **EP 0414613 A3 19911023**; **EP 0414613 B1 19950322**; AT 395127 B 19920925; AT A151490 A 19920215; DD 297114 A5 19920102; DE 3928018 A1 19910228; DK 0414613 T3 19950724; ES 2071057 T3 19950616; JP H03130472 A 19910604; US 5230763 A 19930727

DOCDB simple family (application)

**EP 90402343 A 19900823**; AT 151490 A 19900717; DD 34359090 A 19900823; DE 3928018 A 19890824; DK 90402343 T 19900823; ES 90402343 T 19900823; JP 22142690 A 19900824; US 57186790 A 19900824